

证券代码：300252

证券简称：金信诺

# 深圳金信诺高新技术股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：20240327

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	华泰证券 恒研资本 Baichuan 远望角投 昭图投资 金舵投资 红土创新 运舟资产 鹏华基金
时间	2024年03月27日 14:30-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 伍婧婷 副总经理 李军

<p><b>投资者关系活动主要内容介绍</b></p>	<p><b>Q1：请介绍公司的主要业务情况</b></p> <p>公司主要业务包括通信、特种科工、高速（应用于数据中心领域）、卫星及无线、PCB五大领域。</p> <p>传统通信线缆业务目前在公司整体收入中占比一半，公司在该业务领域深耕多年并有深厚的技术积累，市场格局基本稳定，业务随基建周期呈现波动。</p> <p>特种科工领域是公司通过自主创新在部分产品上实现国产替代的突破，业务已持续供应超十年，目前虽审价后价格下降但公司积极参与新任务定型及开拓，目前收入仍保持规模，同时公司亦积极采取降本降费增效等措施。</p> <p>应用于数据中心领域的高速业务目前已获得国内主流服务器厂商供应商资质并实现稳定交付，海外市场亦在积极开拓；公司在高速领域重点推进高速裸线、服务器交换机内/外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的产品布局。</p> <p>卫星及无线业务作为公司前瞻布局的领域，是公司长期重点投入以及未来主营的方向，目前仍处于战略投入时期，公司已布局了卫星地面通信终端、小基站、核心网、物联网智能终端等产品及技术，但目前收入规模小。</p> <p>PCB是公司目前亏损最多的业务，公司一方面积极对PCB业务采取产品良率专项改善、管理团队引进、减员增效等措施，改善PCB业务经营情况；另一方面大力推进引入战略合作方，争取与合作方从生产运营、市场业务等角度进行深度合作，争取实现减亏、扭亏，提高 PCB 业务效益。</p> <p><b>Q2：铜缆是否能替代光方案</b></p>
-----------------------------	--

我们认为铜方案与光方案是互补共存的关系，不同场景下铜方案与光方案各有优势，市场可以在不同的场景下选择相对优势的方案，并非绝对替代关系。

**Q3：铜方案与光方案相比有哪些优势**

在短距离场景下铜方案在低成本、低能耗和高可靠性上有优势。

**Q4：速率高低对铜材料是否有精度要求，国内是否有技术问题**

随着速率越高对于铜材料的精度要求越高，国内铜原料制造技术非常成熟，能够满足原材料需求。

**Q5：GW200以后铜方案与光模块相比是否散热更好**

铜缆主要材料铜材和塑胶热膨胀系数很低，几乎可以忽略，且铜的热传导系数很低，散热效果更好。

**Q6：目前高速业务客户群体情况**

目前公司国内客户包括浪潮、H3C、联想、富士康、英业达等，海外客户公司亦在积极开拓。

**Q7：海外服务器客户突破情况，是否存在限制**

公司高速业务在海外主要期望突破北美市场，2023年内已获得一家厂商的供应商资质，同时公司具备在海外生产交付的经验（前期已在泰国设立工厂并生产通信线缆相关产品），目前也计划在海外建设部分高速产能。

**Q8：公司目前卫星项目情况**

	<p>目前高频通信天线项目在2023年内已延期；同时公司有布局的专为低轨卫星系统中低速车、船、机载卫星互联网应研制相控阵终端的项目，但需要待低轨星座实现组网后才有实现大量商用化的机会。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年03月27日